

2026年3月期 決算説明資料

2026年5月11日

 **JX金属株式会社**

1

ハイライト

2

2025年度（2026年3月期） 通期実績

3

2026年度（2027年3月期） 通期見通し

4

Appendix

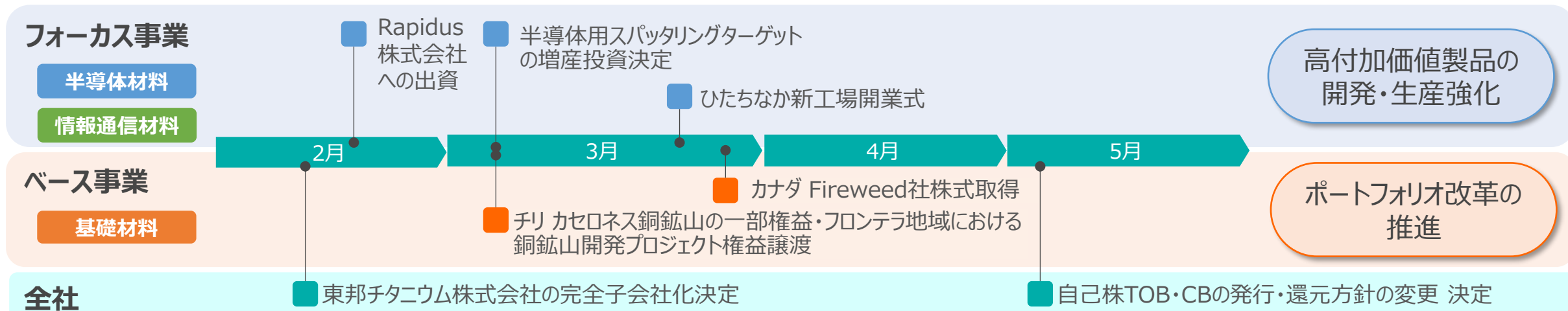
ハイライト

ハイライト - 2025年度通期実績・2026年度通期見通し

2025年度 通期 実績	営業利益	2024年度実績 1,125 億円 為替 153 円/USD 銅価 425 ¢/lb	2025年度実績 1,750 億円 為替 151 円/USD 銅価 491 ¢/lb	差異 +625 億円 為替 2 円/USD 円高 銅価 +66 ¢/lb	フォーカス事業主力製品の増販に加え、銅価上昇等も寄与し、増益
	配当	18 円*	31 円	+13 円	増益に伴い増配予定
2026年度 通期 見通し	営業利益	2025年度実績 1,750 億円 為替 151 円/USD 銅価 491 ¢/lb	2026年度見通し 1,900 億円 為替 150 円/USD 銅価 520 ¢/lb	差異 +150 億円 為替 1 円/USD 円高 銅価 +29 ¢/lb	AIデータセンター関連需要の拡大継続および販売単価改善等によるフォーカス事業の成長継続を主因に増益見込み なお、中東危機影響▲70億円を織り込み

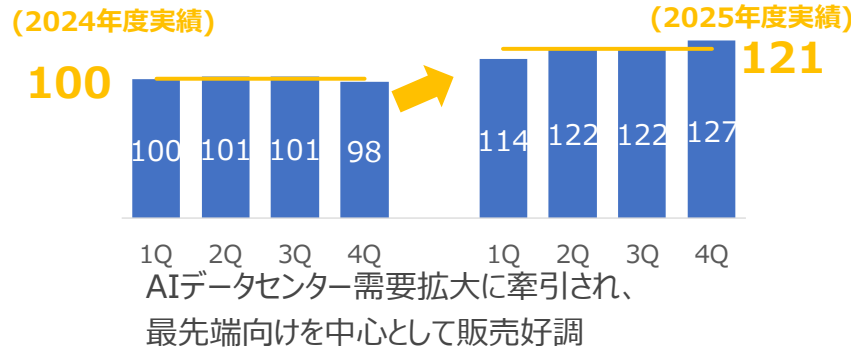
トピックス（2月～5月の主なリリース）

* 2024年11月に実施した配当(850億円)は除く

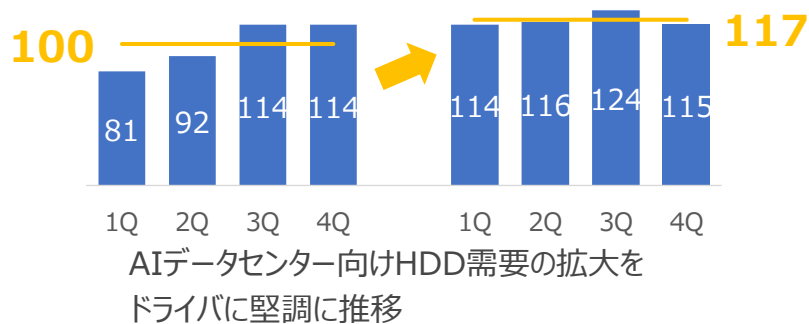


ハイライト - 主な製品 販売数量 2025年度実績 対 2024年度実績 (2024年度実績 = 100として指数化)

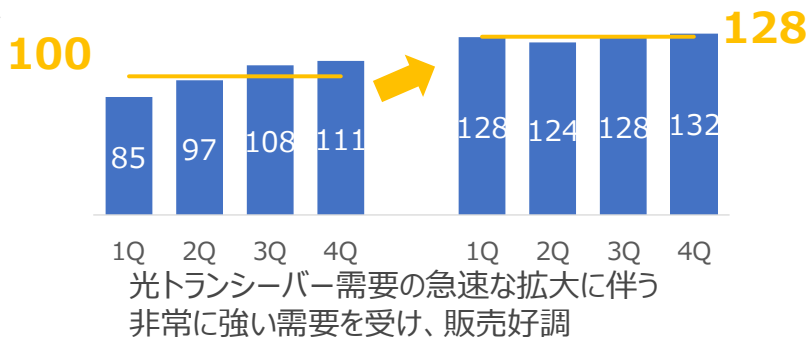
① 半導体用ターゲット



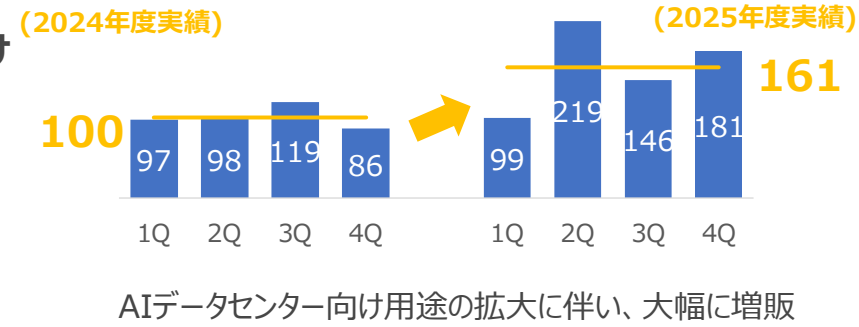
② 磁性材用ターゲット



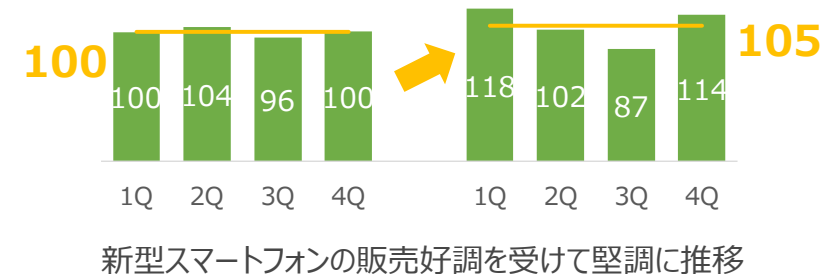
③ インジウムリン (InP)基板



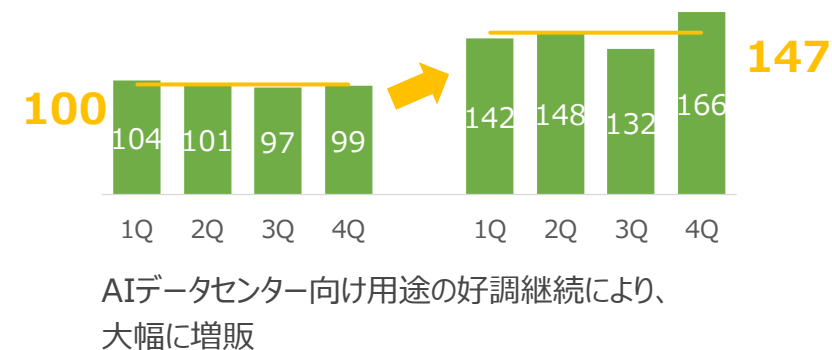
④ キャパシタ向けタンタル粉



① 圧延銅箔



② チタン銅



半導体材料

TaNb*

*TaNb : タンタル・ニオブ

情報通信材料

機能材料

半導体材料
薄膜材料

ハイライト - 主な製品 販売数量 2026年度見通し 対 2025年度実績 (増減率)

1 半導体用 ターゲット

+ 19%

AIデータセンター関連需要の拡大
継続に伴い、最先端向けを中心と
して増販見込み
需要拡大に応える安定供給体制
構築のため、ひたちなか新工場の
増産投資を着実に実行

2 磁性材用 ターゲット

+ 7%

AIデータセンター向け需要は底堅く
推移し、増販見込み

3 インジウムリン (InP)基板

+ 13%

非常に強い需要が継続
生産効率改善により、生産能力の
最大化を図る

半
導
体
材
料

TaNb*

4 キャパシタ向け タンタル粉

+ 16%

AIデータセンター向け用途の需要拡大
継続により、増販を計画

*Ta Nb : タンタル・ニオブ

1 圧延銅箔

+ 5%

スマートフォンの高機能化に伴う採用
面積増により増販を見込む

2 チタン銅

+ 32%

AIデータセンター向け需要の拡大に
伴い、更なる増販を計画

情
報
通
信
材
料

機
能
材
料

半
導
体
材
料

薄
膜
材
料

ハイライト – ポートフォリオ変革の進捗 ～ひたちなか新工場開業～

- ✓ ベース事業において事業規模の適正化を行い、得られた資金をフォーカス事業の成長投資や、サプライチェーン強化に活用
- ✓ 今後も長期ビジョンに沿ったフォーカス事業中心のポートフォリオに向けて、ベース事業の最適な体制構築を推進

これまでの主な取り組み

事業規模の適正化

- カセロネス銅鉱山権益の一部売却 (100%→30%)
- ロス・ペランブレス銅鉱山権益の一部売却 (15.79%→12.52%)
- パンパシフィック・銅業株式の一部譲渡による持分法適用子会社化 (67.8%→47.8%)

サプライチェーン強化

- Mibra鉱山(タンタル)投資
- Copi PJ(レアメタル・レアアース)参入

当期の取り組み

銅鉱山権益の譲渡

カセロネス銅鉱山の一部権益 (30%→25%) および、フロンテラ地域における銅鉱山開発プロジェクトの権益を約340億円で譲渡することに合意



約340億円

成長投資

約230億円

サプライチェーン強化

約54億円

ひたちなか新工場における半導体用ターゲットの増産に向けた設備投資

- AI データセンター用途における半導体の需要拡大を背景に能力増強を決定
- 2027年度下期より順次稼働、2023年度比1.6倍の増強を予定

※2023年度公表済みのひたちなか新工場への投資1,500億円の内数



Fireweed Metals Corp. への出資およびプロジェクト参画

- 亜鉛・鉛・銀に加え、タングステン、ガリウム、ゲルマニウムといったレアメタルの供給ポテンシャルを有する複数のプロジェクトを推進するFireweed社の株式を5%取得

ハイライト – 東邦チタニウム完全子会社化

- ✓ 株式交換により東邦チタニウムの完全子会社化を決定
- ✓ グループ会社シナジーを活用し、更なる事業成長および新規事業領域の拡大を図る

完全子会社化の背景

東邦チタニウムを J X 金属の完全子会社とすることで、両社間の情報・人的資源の共有および経営資源の一体活用を進め、柔軟かつ迅速で長期的な視点に立った意思決定体制を構築することが、グループ全体の企業価値最大化に資すると判断したため

※スポンジチタン事業の分社化：長期保有が可能かつ信頼できる株主による資本参画が、より安定した事業基盤の構築、企業価値向上に一層資すると考え、既存株主かつ重要な取引先である日本製鉄株式会社の資本参画について検討を開始

本株式交換の詳細

- 現状の持分比率：50.37%
- 実施予定日（効力発生日）2026年6月1日（予定）
- 割当ての内容

	JX金属 (株式交換完全親会社)	東邦チタニウム (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率	1	0.70
本株式交換により交付する株式数	JX金属株式：24,728,687株（予定）	

期待するシナジー

- ✓ 東邦チタニウムの有する技術の活用による半導体材料関連事業の強化
- ✓ チタン資源供給強化によるサプライチェーンの安定化
- ✓ コア技術の融合による新規事業創出機会の拡大
- ✓ 両社の経営資源の効率的活用及び事業強靱化に関する知見の展開

例：CVD/ALDプリカーサ材料の開発・量産

- 当社の高純度化技術及び東邦チタニウムの塩化技術を活用
- 東邦チタニウムの茅ヶ崎工場および当社の茨城事業所（日立地区）にて量産開始済



ハイライト – 自己株式の公開買付け（自己株TOB）について

背景

- 上場来、特定の株主が40%以上の当社普通株式を所有していることは、当社の資本政策の柔軟性の確保、資本関係の見直しによる市場からの評価向上を図る観点から、当社にとって最適な資本構成ではないという状況を課題として認識
- 上場後1年で、財務体質改善および各事業の成長施策が着実に進展し、当社として資本構成の最適化および資本効率重視へ舵を切る局面において、ENEOS HDから当社普通株式の一部を売却する意向を受け検討開始

キャピタルアロケーション方針で最優先とするフォーカス事業等への成長投資や、財務体質の健全性とのバランスを考慮し、最適なスキームを検討

自己株式の公開買付け

- 特定株主の所有比率を確実にかつ定量的に低減しつつ、全株主に同一条件での応募機会を提供
- 特定株主からディスカウントで自己株取得することにより、自己株TOBに応募しない他の既存株主にとっても利益に繋がる
- 市場流通する発行済株式が減少し、EPS・ROEの構造的な改善および株主への還元に繋がる

ハイライト – 転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行について

- ✓ 2,500億円規模のCB発行を決定
- ✓ 調達資金は、全額自己株式公開買付け資金に充当する（残額が生じた場合は成長投資へ充当）

転換社債型新株 予約権付社債（CB）とは

新株予約権が付された形態で発行される社債であり、発行時に定められた値段（転換価額）で社債を株式に転換することが可能。発行時点では株式の希薄化を伴わず、社債としての安定性と株式への転換可能性を併せ持つ資金調達手段

CB発行による調達を選択した目的・理由

調達コストの最小化

金利上昇が見込まれる中で、通常の社債発行や借入と比較し、ゼロ・クーポン^{*1}/オーバー・パー発行^{*2}により、資金調達コストの最小化を図ることが可能

財務戦略の柔軟性確保

当社のキャピタルアロケーション方針を踏まえ、フォーカス事業への成長投資を最優先し、資本増強の性質も備え得る資金調達方法であるCB発行により、中長期的に柔軟な財務戦略の選択が可能

*1 ゼロ・クーポン：利息（クーポン）支払いがないこと

*2 オーバー・パー発行：社債額面を上回る払込金額での発行

ハイライト – キャピタルアロケーション方針について

当社のキャピタルアロケーション方針

成長投資を最優先としながら、財務体質を改善するとともに、一定の株主還元を行う

これまでの株主還元方針

連結配当性向 **20%** 程度

加えて、当社の想定対比で銅価が上昇した結果として、ベース事業の利益が上振れた分については、その一部も株主に還元

下記の目的のため、**還元方針の変更を決定**

- ① 還元方針の簡略化による予見性の向上
- ② チタン事業を行う東邦チタニウムの完全子会社化予定を踏まえ、銅価のみとの連動を廃止

今後の株主還元方針

連結配当性向 **25%** 程度

を基本とし、利益が下振れた場合に備え、株主の皆様へ安定した配当を実現するため、

配当の下限を **20円/株** と設定

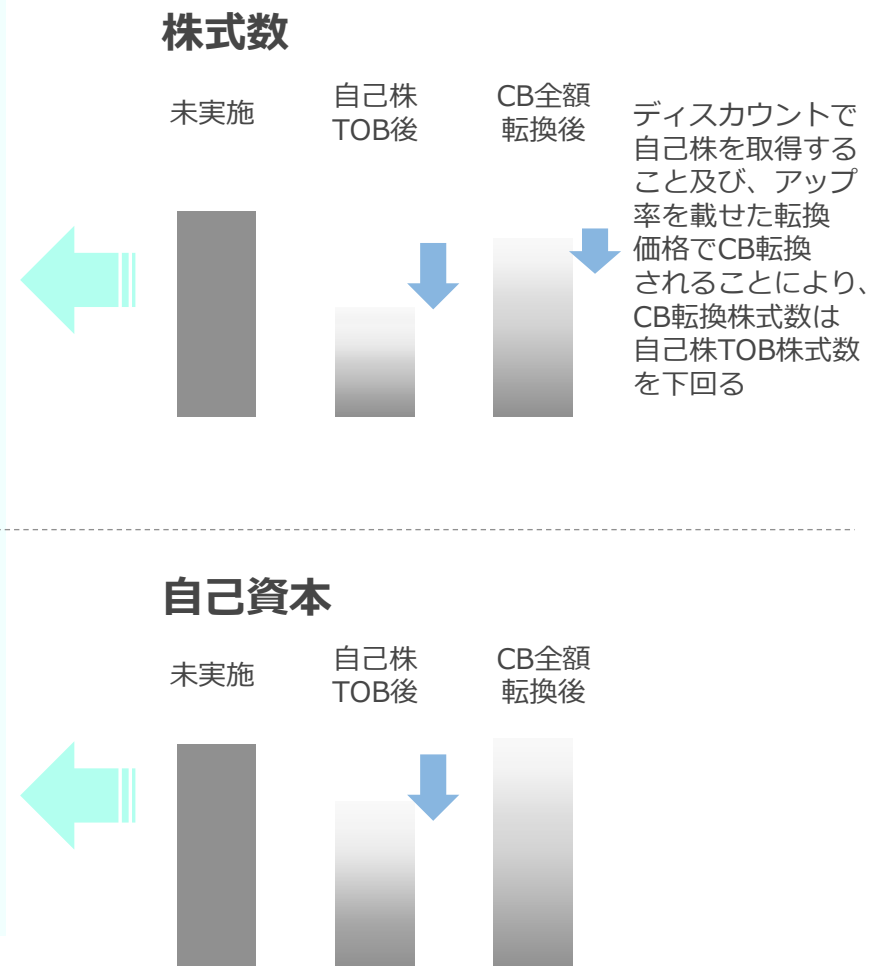
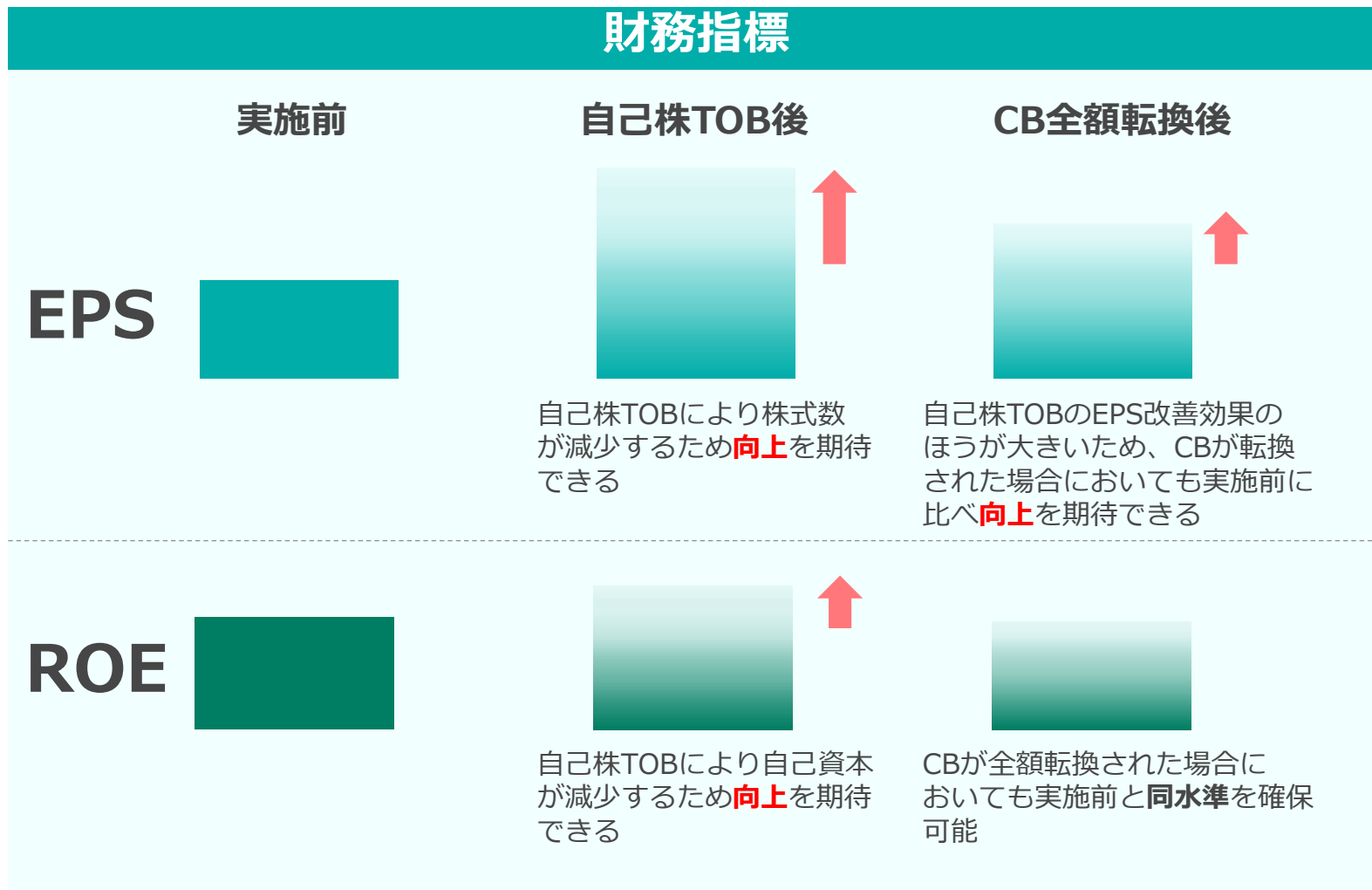
※ただし、資産売却や自己株取得などBSへ大きな影響を与える事象があった場合は総還元性向も考慮して都度検討

→ **2027年3月期については**
多額の自己株取得により資本が大きく圧縮されるため、
配当は下限の20円/株とする
(参考：2027年3月期の総還元性向は約235%)

※自己株式取得額 2,500億円想定

ハイライト – 当社財務指標への影響イメージ

✓ EPS・ROEを重視した中長期的な企業価値の向上を今後も推進していく



※前提条件として、親会社の所有者に帰属する当期利益は2026年度見通しで一定と仮定
 ※東邦チタニウム株式交換による株式数や自己資本の変動は織り込み済み

中長期事業目標

✓ 目標達成に向け、着実に進捗中

		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	(参考)	2027年度
		実績	実績	実績	見通し	CAGR (2023年度-2026年度)	目標
営業利益	[連結]	862 億円	1,125 億円	1,750 億円	1,900 億円	(30%)	CAGR10%~15% (2023年度-2027年度)
	(YoY成長率)		30.5%	55.6%	8.6%		
	[フォーカス事業]	273 億円	518 億円	710 億円	820 億円	(44%)	CAGR35%~40% (2023年度-2027年度)
	(YoY成長率)		89.7%	37.1%	15.5%		
営業利益率	[連結]	5.7%	15.7%	19.8%	20.4%		12%~17%
	[フォーカス事業]	8.8%	12.5%	14.3%	15.5%		15%~20%
	[半導体材料セグメント]	21.4%	18.0%	22.3%	25.0%		25%~30%
	[情報通信材料セグメント]	0.5%	9.5%	9.9%	9.7%		8%~13%
営業利益構成比率	[フォーカス事業]	26%	41%	34%	40%		67%以上
	[半導体材料セグメント]	25%	21%	19%	24%		45%以上
ROE		18.3%	11.0%	15.6%	17.1%		10%以上
NET Debt/EBITDA倍率		2.6倍	1.6倍	1.2倍	1.9倍		1.5倍未満

2025年度（2026年3月期） 通期実績

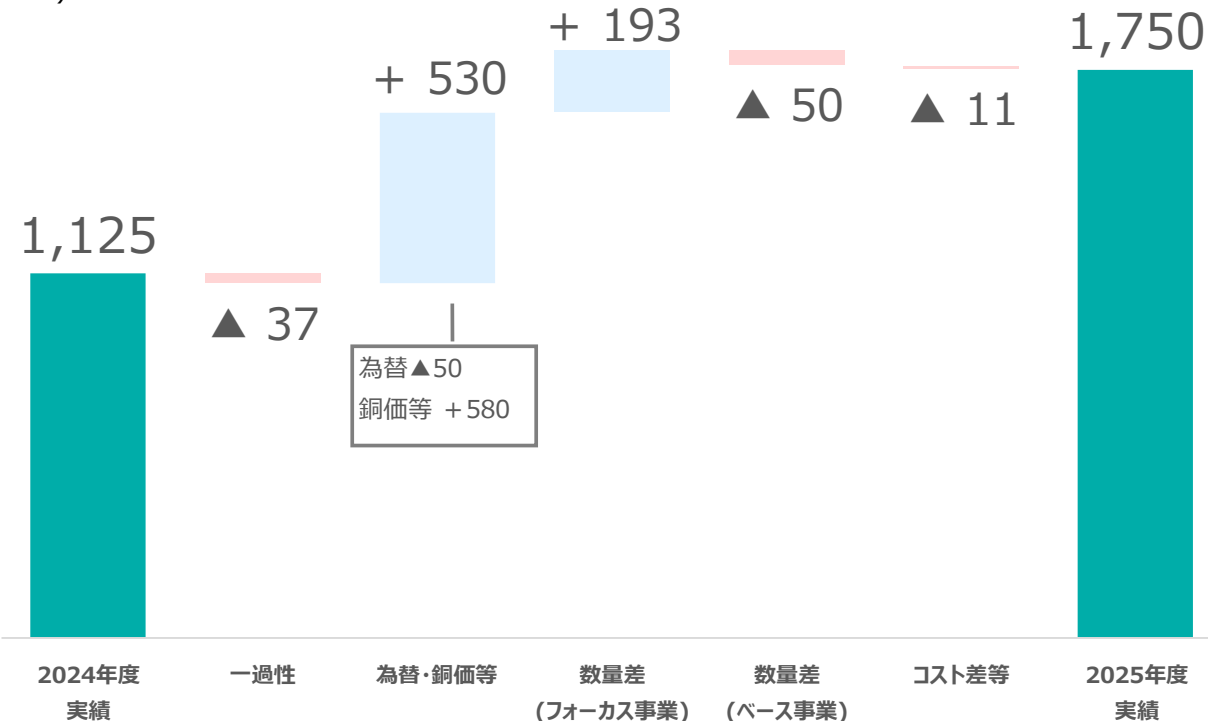
連結損益計算書

(億円)	2024年度	2025年度	前年同期比		
	実績	実績	差異	増減率	
売上高	7,149	8,846	+ 1,697	+24%	
(フォーカス事業)	4,131	4,959	+ 828	+20%	
(ベース事業)	3,065	4,079	+ 1,014	+33%	
(その他)	▲ 47	▲ 192	▲ 145	-	
営業損益	1,125	1,750	+ 625	+56%	
(フォーカス事業)	518	710	+ 192	+37%	
(ベース事業)	745	1,395	+ 650	+87%	
(その他)	▲ 138	▲ 355	▲ 217	-	
税引前利益	1,075	1,691	+ 616	+57%	
当期利益	814	1,287	+ 473	+58%	
親会社の所有者に 帰属する当期利益	683	1,046	+ 363	+53%	
為替(円/USD)	153	151	▲ 2	▲1%	
LME銅価(¢/lb)	平均	425	491	+ 66	+16%
	前期末/当期末	396/439	439/552		

事業セグメント別 売上高及び営業損益

営業損益差異

(億円)



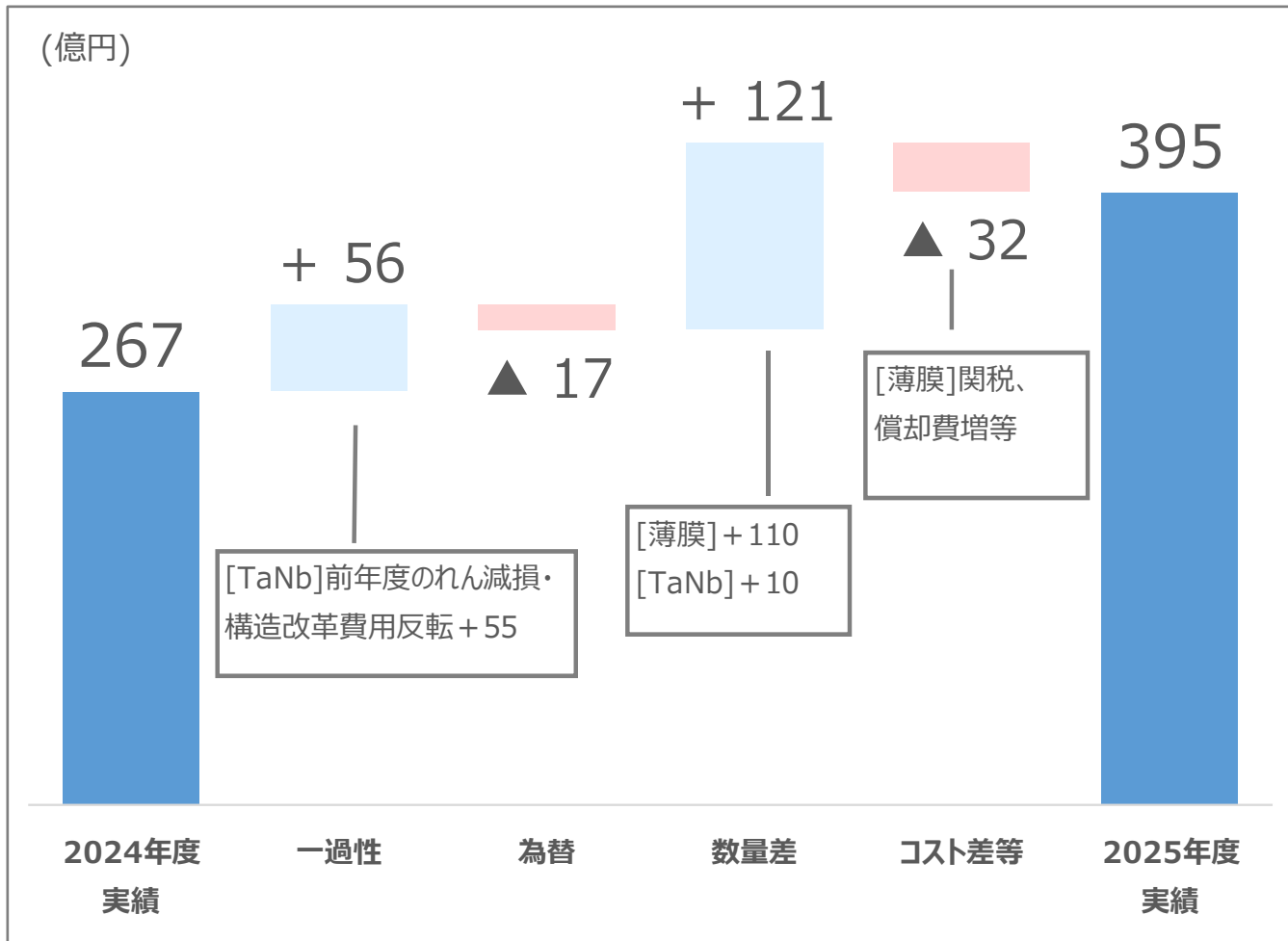
		(億円)	2024年度	2025年度	前年同期比	
			実績	実績	差異	増減率
フォーカス事業	半導体材料	売上高	1,480	1,772	+ 292	+20%
		営業損益	267	395	+ 128	+48%
	情報通信材料	売上高	2,651	3,187	+ 536	+20%
		営業損益	251	315	+ 64	+25%
ベース事業	基礎材料	売上高	3,065	4,079	+ 1,014	+33%
		営業損益	745	1,395	+ 650	+87%
その他	事業共通費用等	売上高	▲ 47	▲ 192	▲ 145	-
		営業損益	▲ 138	▲ 355	▲ 217	-
合計		売上高	7,149	8,846	+ 1,697	+24%
		営業損益	1,125	1,750	+ 625	+56%

	2024年度実績	一過性	為替・銅価等	数量差 (フォーカス事業)	数量差 (ベース事業)	コスト差等	2025年度実績
(内訳)		▲ 37	+ 530	+ 193	▲ 50	▲ 11	
半導体		+ 56	▲ 17	+ 121	-	▲ 32	
情報通信		▲ 36	▲ 1	+ 72	-	+ 29	
基礎		+ 142	+ 548	-	▲ 50	+ 10	
その他		▲ 199	-	-	-	▲ 18	

環境対策引当金計上
 (2026年5月11日リリース「JX金属エコマネジメント・札幌事業所におけるおしどり沢堆積場保管容量の増強について」)

営業損益差異分析 半導体材料セグメント[2025年度実績 対 2024年度実績]

営業損益差異分析



事業別概況

薄膜材料

- AIデータセンター関連需要の拡大を受けた主力製品の増販により、為替円高を吸収して増益

タンタル・ニオブ (Ta Nb)

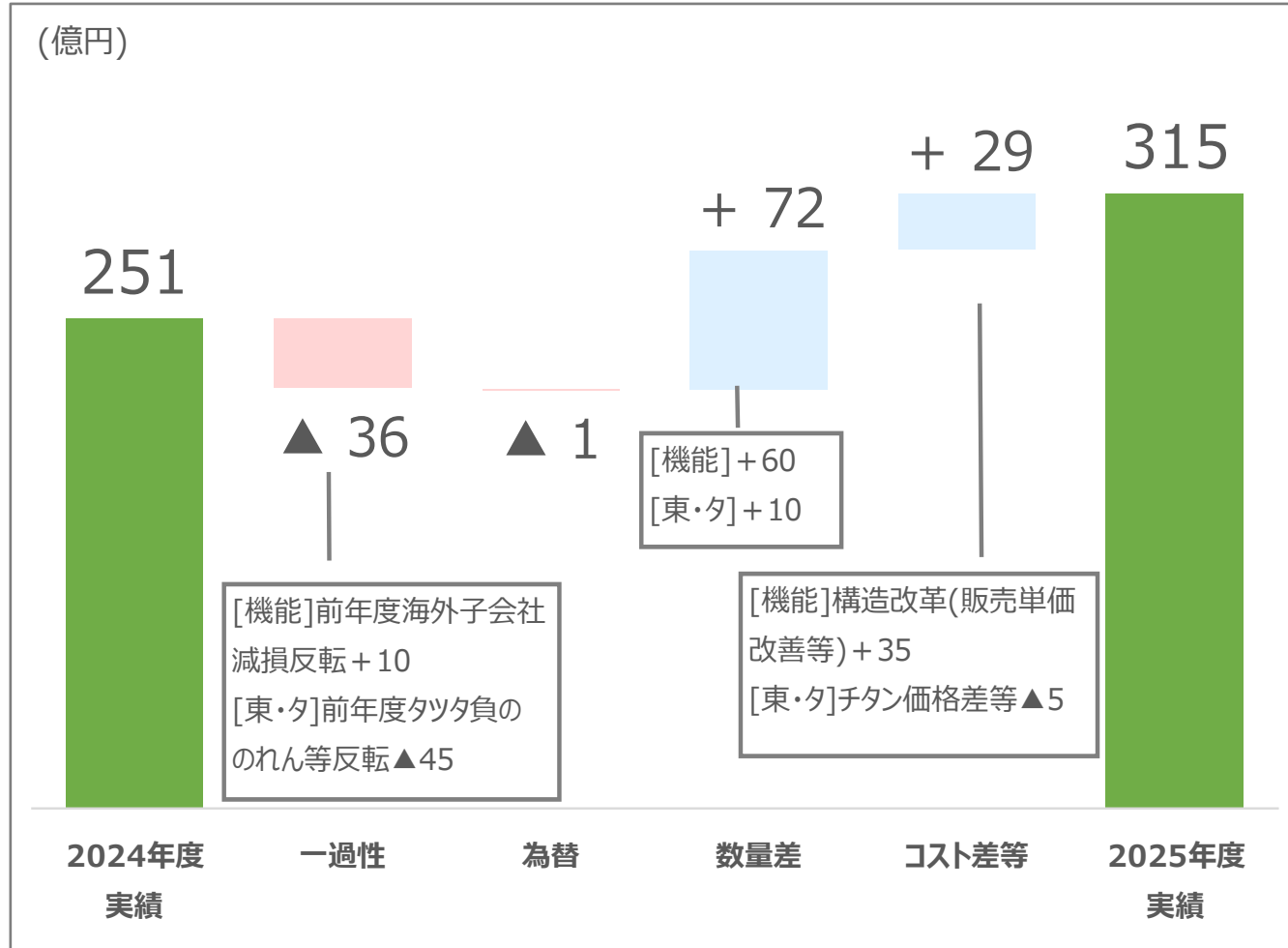
- 前年度のれん減損・構造改革費用の反転に加え、キャパシタ向けタンタル粉の大幅な増販、販売単価改善等により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2024年度	2025年度	前年同期比	
		実績	実績	差異	増減率
薄膜材料	売上高	1,275	1,470	+ 195	+15%
	営業損益	342	409	+ 67	+20%
タンタル・ニオブ (Ta Nb)	売上高	345	458	+ 113	+33%
	営業損益	▲ 68	▲ 7	+ 61	-
調整等	売上高	▲ 140	▲ 156	▲ 16	-
	営業損益	▲ 7	▲ 7	-	-
セグメント合計	売上高	1,480	1,772	+ 292	+20%
	営業損益	267	395	+ 128	+48%

営業損益差異分析 情報通信材料セグメント[2025年度実績 対 2024年度実績]

営業損益差異分析



事業別概況

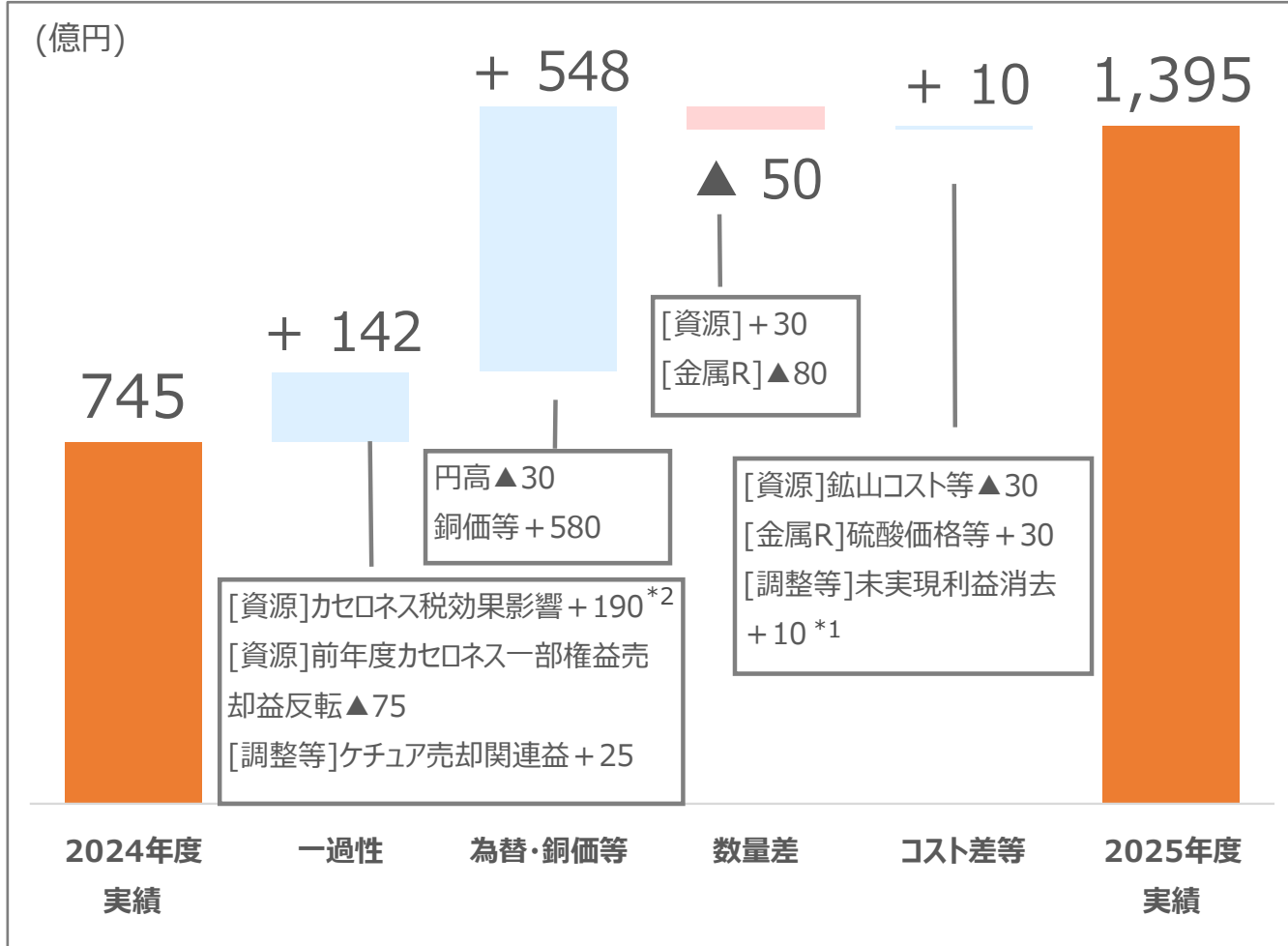
- 機能材料** - スマートフォン市場の回復、AIデータセンター用途での採用拡大に伴う増販、構造改革(価格改定等)の進展等により為替円高を吸収して大幅増益
- 東邦チタニウム** - 価格影響等により減益
- タツタ電線** - 前年度計上 負ののれん等の反転を主因に減益

事業別 売上高・営業損益

事業	億円	2024年度	2025年度	前年同期比	
		実績	実績	差異	増減率
機能材料	売上高	1,393	1,602	+ 209	+15%
	営業損益	128	211	+ 83	+65%
東邦チタニウム、 タツタ電線等	売上高	1,258	1,585	+ 327	+26%
	営業損益	123	104	▲ 19	▲15%
セグメント合計	売上高	2,651	3,187	+ 536	+20%
	営業損益	251	315	+ 64	+25%

営業損益差異分析 基礎材料セグメント[2025年度実績 対 2024年度実績]

営業損益差異分析



事業別概況

- 資源**
 - 前年度カセロネス権益一部譲渡に伴う売却益反転の一方、銅価等の上昇や、カセロネスにおける税効果影響^{*2}を主因に増益
- 金属・リサイクル (金属R)**
 - 一過性トラブルによる減産はあるものの銅価等上昇を主因に増益
- 調整等**
 - ケチュア売却関連益により増益

事業別 売上高・営業損益

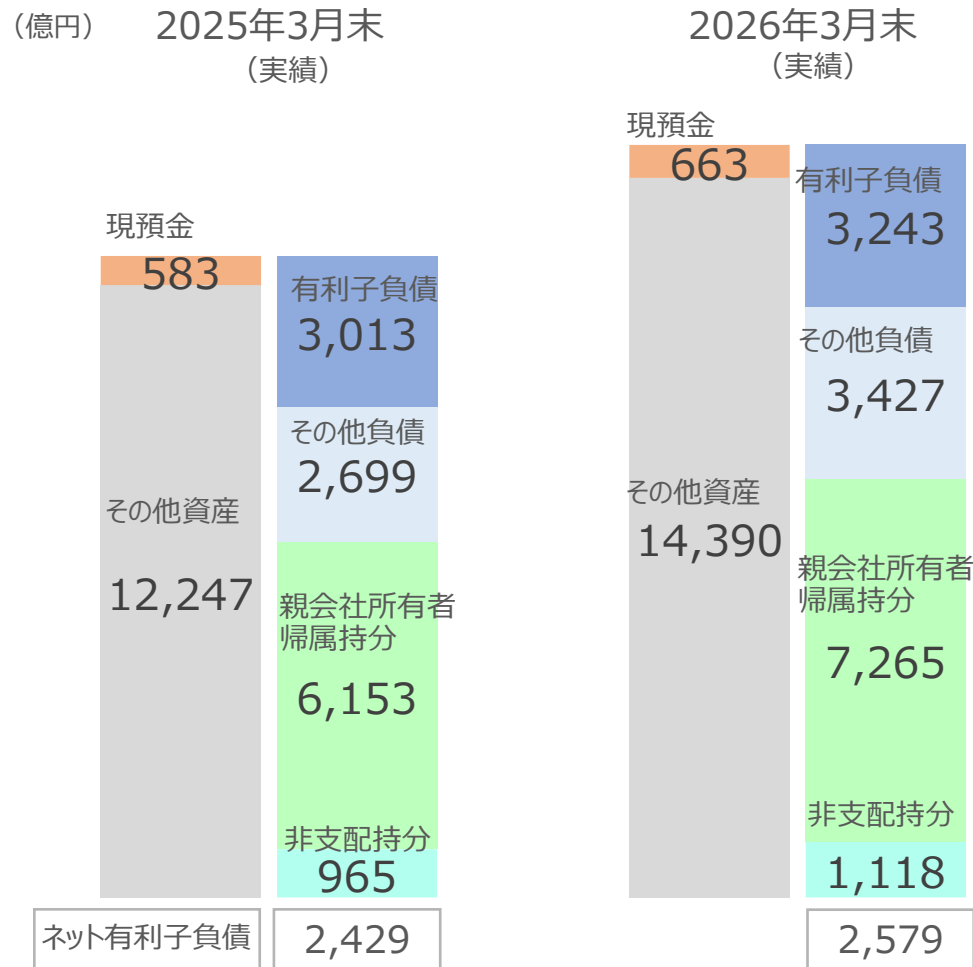
	億円	2024年度	2025年度	前年同期比	
		実績	実績	差異	増減率
資源	売上高	53	57	+ 4	+8%
	営業損益	556	1,009	+ 453	+81%
金属・リサイクル (金属R)	売上高	3,012	4,021	+ 1,009	+33%
	営業損益	209	376	+ 167	+80%
調整等	売上高	-	-	-	-
	営業損益	▲ 20	10	+ 30	-
セグメント合計	売上高	3,065	4,079	+ 1,014	+33%
	営業損益	745	1,395	+ 650	+87%

*1 パンパシフィック・銅の支配喪失による持分法適用会社化に伴い、2023年度末に未実現利益がすべて実現。2024年度は、利益の消去のみが発生し、一時的に消去額が過多

*2 チリ現地決算において回収可能額の見直しにより繰延税金資産追加計上 (持分法取込)

連結バランスシート・キャッシュフロー/投融資・減価償却費・研究開発費/株主還元

■ 連結バランスシート



フォーカス事業における将来の増産に向けた投資の支出等により、ネット有利子負債増加

■ 連結キャッシュフロー

(億円)

	2025年度 実績
営業キャッシュフロー	1,075
投資キャッシュフロー	▲ 773
フリーキャッシュフロー	303
財務キャッシュフロー	▲ 249
現金同等物の増減額	54
為替変動による影響等	26

■ 株主還元

配当方針

連結配当性向20%程度を基本とした上で、当社の想定対比で銅価が上昇した結果として、ベース事業の利益が上振れた分については、その一部も株主に還元する方針

■ 投融資・減価償却費・研究開発費

(億円)

	2023年度 実績	2024年度 実績	2025年度 実績
投融資	792	923	845
減価償却費	391	440	447
研究開発費	159	178	200

	2025年 3月期	2026年 3月期			
		2月公表時		実績	
1株あたり 配当金 ※2	18円 ※1	27円		31円	
		中間 6円	期末 21円	中間 6円	期末 25円
配当性向 ※2	24%	27%		27%	

※1 2024年11月に実施した配当(850億円)は除く
 ※2 銅価上昇を反映

2026年度（2027年3月期） 通期見通し

連結損益計算書

(億円)	2025年度	2026年度	前年同期比		
	実績	見通し	差異	増減率	
売上高	8,846	9,300	+ 454	+5%	
(フォーカス事業)	4,959	5,300	+ 341	+7%	
(ベース事業)	4,079	4,200	+ 121	+3%	
(その他)	▲ 192	▲ 200	▲ 8	-	
営業損益	1,750	1,900	+ 150	+9%	
(フォーカス事業)	710	820	+ 110	+15%	
(ベース事業)	1,395	1,240	▲ 155	▲11%	
(その他)	▲ 355	▲ 160	+ 195	-	
税引前利益	1,691	1,780	+ 89	+5%	
当期利益	1,287	1,400	+ 113	+9%	
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,046	1,140	+ 94	+9%	
為替(円/USD)	151	150	▲ 1	▲1%	
LME銅価(¢/lb)	平均	491	520	+ 29	+6%
	前期末/当期末	439/552	552/520		

銅価推移



営業利益感応度 (年間)

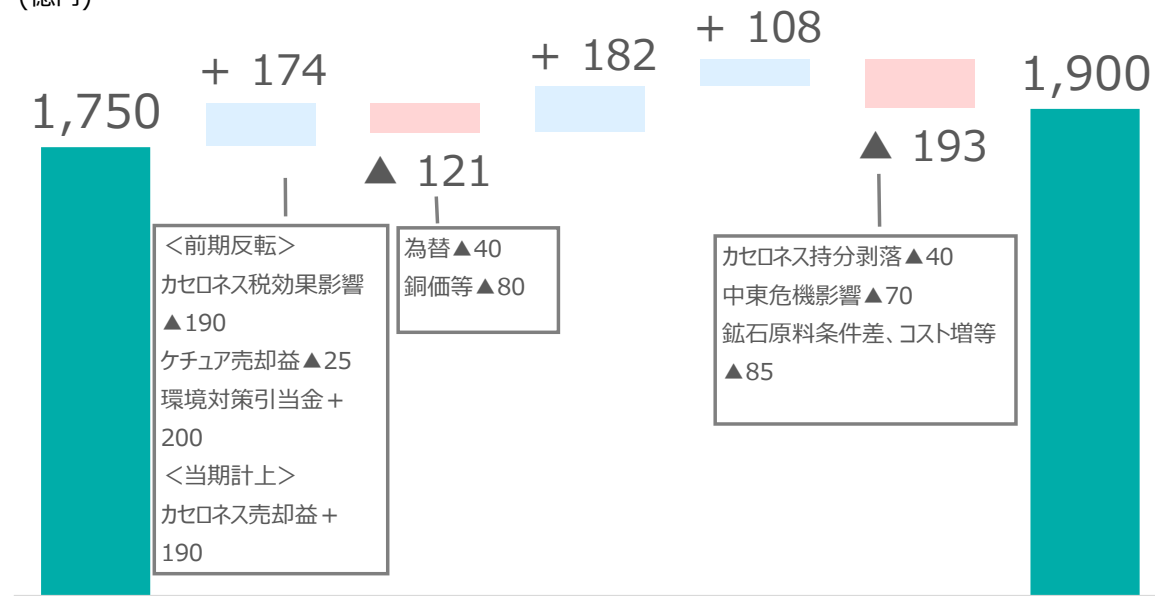
単位：億円	為替 5円円安	銅価 + 10¢/lb
フォーカス事業	+ 40	-
ベース事業	+ 50	+ 40
合計	+ 90	+ 40

事業セグメント別 売上高及び営業損益

	(億円)	2025年度		2026年度		前年同期比	
		実績	見通し	差異	増減率		
フォーカス事業	半導体材料	売上高	1,772	2,000	+ 228	+13%	
		営業損益	395	500	+ 105	+27%	
	情報通信材料	売上高	3,187	3,300	+ 113	+4%	
		営業損益	315	320	+ 5	+2%	
ベース事業	基礎材料	売上高	4,079	4,200	+ 121	+3%	
		営業損益	1,395	1,240	▲ 155	▲11%	
その他	事業共通費用等	売上高	▲ 192	▲ 200	▲ 8	-	
		営業損益	▲ 355	▲ 160	+ 195	-	
合計	売上高	8,846	9,300	+ 454	+5%		
	営業損益	1,750	1,900	+ 150	+9%		

営業損益差異

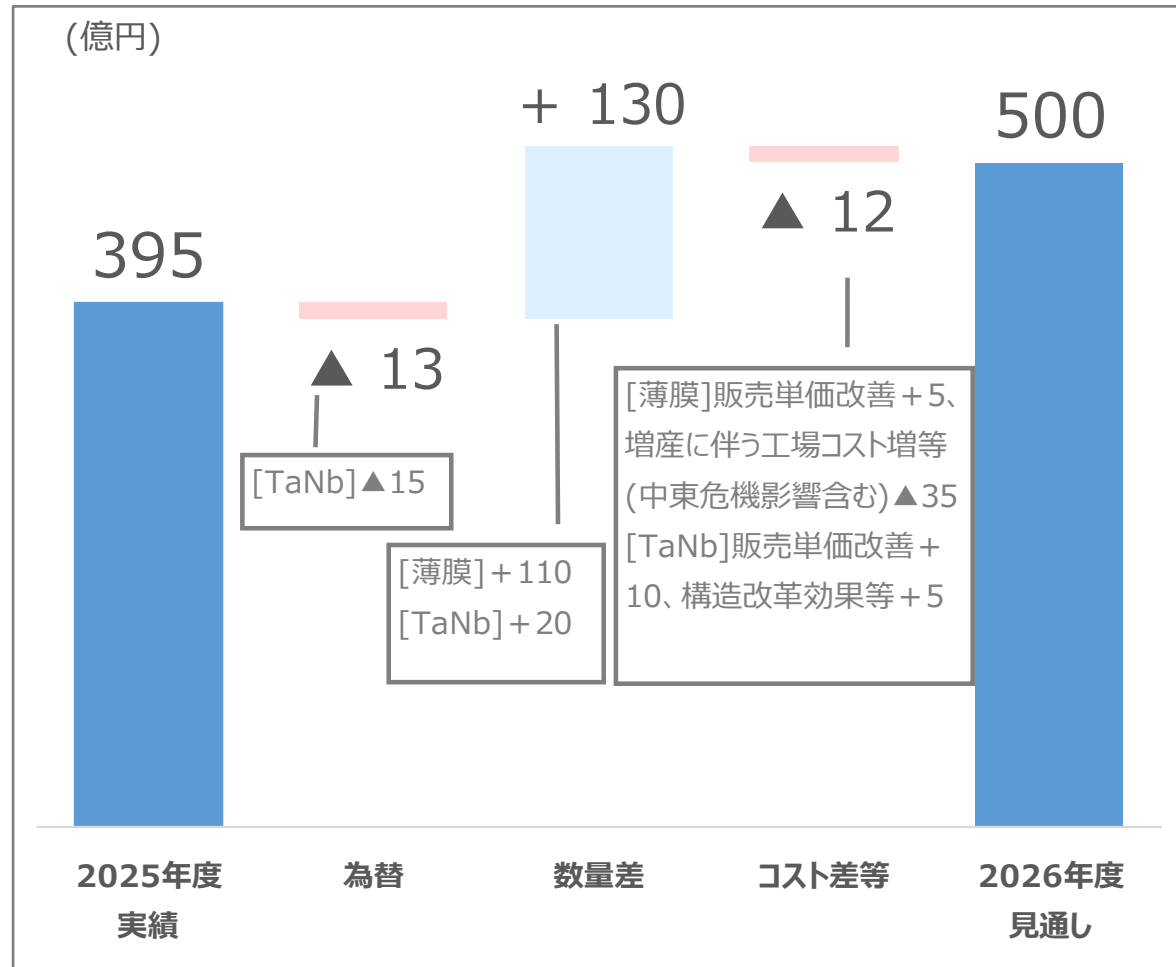
(億円)



	2025年度実績	一過性	為替・銅価等	数量差 (フォーカス事業)	数量差 (ベース事業)	コスト差等	2026年度見通し	詳細記載ページ
(内訳)		+ 174	▲ 121	+ 182	+ 108	▲ 193		
半導体		-	▲ 13	+ 130	-	▲ 12		p.24
情報通信		-	▲ 27	+ 52	-	▲ 20		p.25
基礎		▲ 25	▲ 81	-	+ 108	▲ 157		p.26
その他		+ 199	-	-	-	▲ 4		

営業損益差異分析 半導体材料セグメント[2026年度見通し 対 2025年度実績]

営業損益差異分析



事業別概況

薄膜材料

- 中東危機影響含めコスト増を見込むものの、半導体用ターゲット、InP基板等、AIデータセンター関連の需要拡大を受けた増販および販売単価改善を主因に増益

タンタル・ニオブ (TaNb)

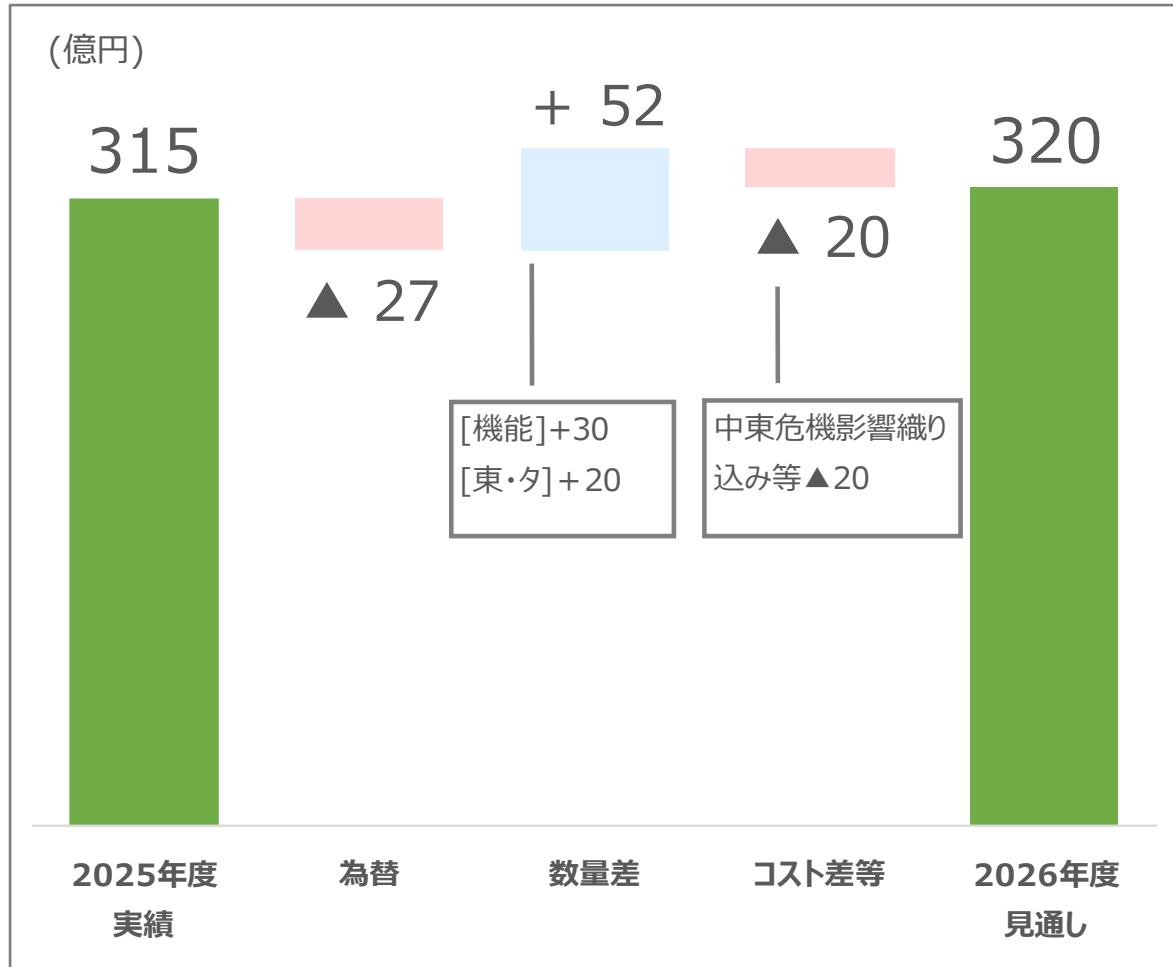
- AIデータセンター関連を主としたキャパシタ向けタンタル粉増販や販売単価改善、構造改革効果取り込み等により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2026年度	前年同期比	
		実績	見通し	差異	増減率
薄膜材料	売上高	1,470	1,700	+ 230	+16%
	営業損益	409	490	+ 81	+20%
タンタル・ニオブ (TaNb)	売上高	458	500	+ 42	+9%
	営業損益	▲ 7	10	+ 17	-
調整等	売上高	▲ 156	▲ 200	▲ 44	-
	営業損益	▲ 7	-	+ 7	-
セグメント合計	売上高	1,772	2,000	+ 228	+13%
	営業損益	395	500	+ 105	+27%

営業損益差異分析 情報通信材料セグメント[2026年度見通し 対 2025年度実績]

営業損益差異分析



事業別概況

機能材料

- 圧延銅箔、AIデータセンター向けチタン銅の増販を主因に増益

東邦チタニウム、 タツタ電線等

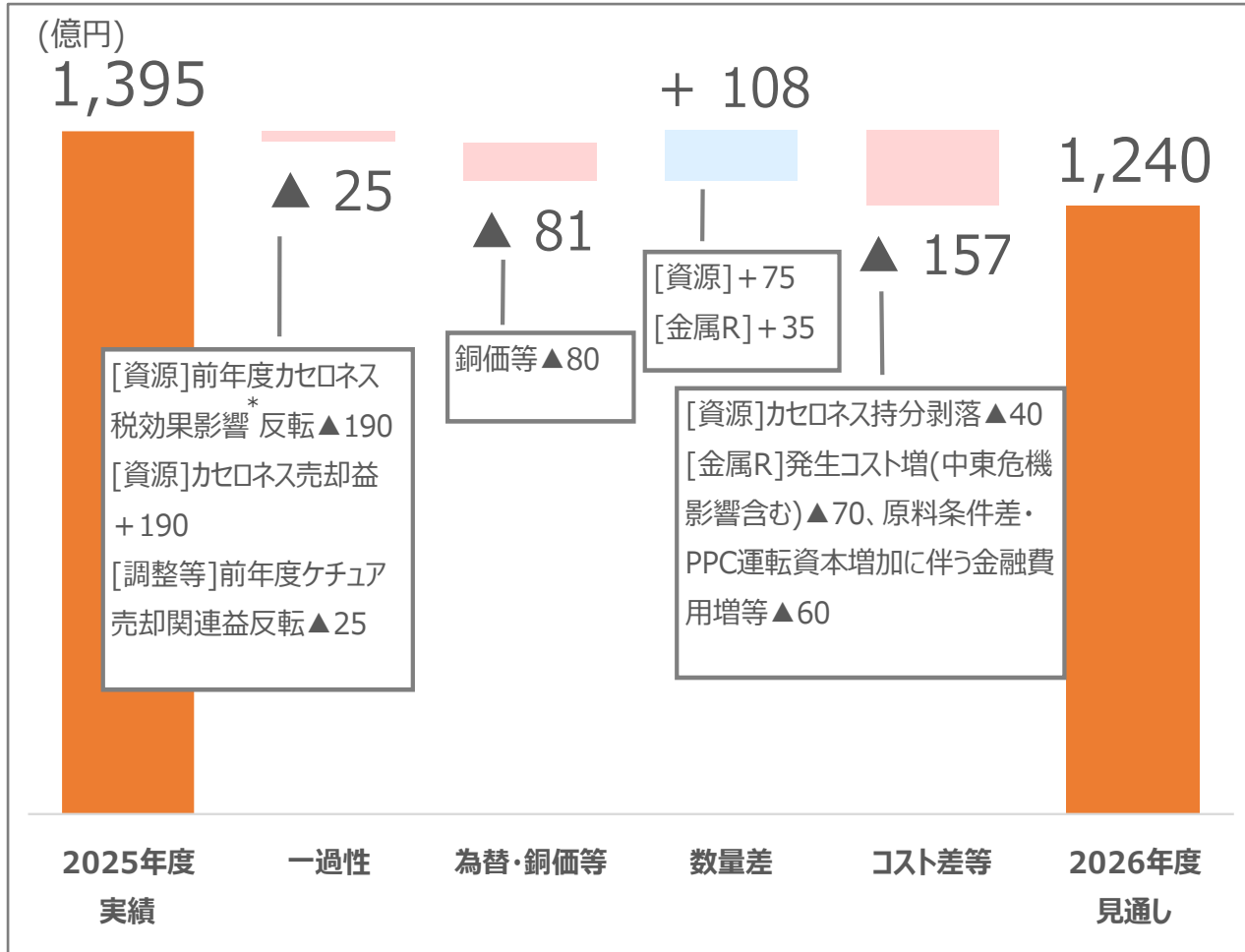
- 為替影響や、中東危機影響織り込み等により減益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2026年度	前年同期比	
		実績	見通し	差異	増減率
機能材料	売上高	1,602	1,600	▲ 2	▲0%
	営業損益	211	230	+ 19	+9%
東邦チタニウム、 タツタ電線等	売上高	1,585	1,700	+ 115	+7%
	営業損益	104	90	▲ 14	▲13%
セグメント合計	売上高	3,187	3,300	+ 113	+4%
	営業損益	315	320	+ 5	+2%

営業損益差異分析 基礎材料セグメント[2026年度見通し 対 2025年度実績]

営業損益差異分析



事業別概況

- 資源**
 - 環境要因やカセロネス権益一部譲渡に伴う利益剥落を主因に減益
- 金属・リサイクル(金属R)**
 - 中東危機影響を含めた製錬コスト増、原料条件差、原料価格上昇に伴う運転資本増加による金融コスト増(PPC)等により減益
- 調整等**
 - ケチュア売却関連益反転を主因に減益

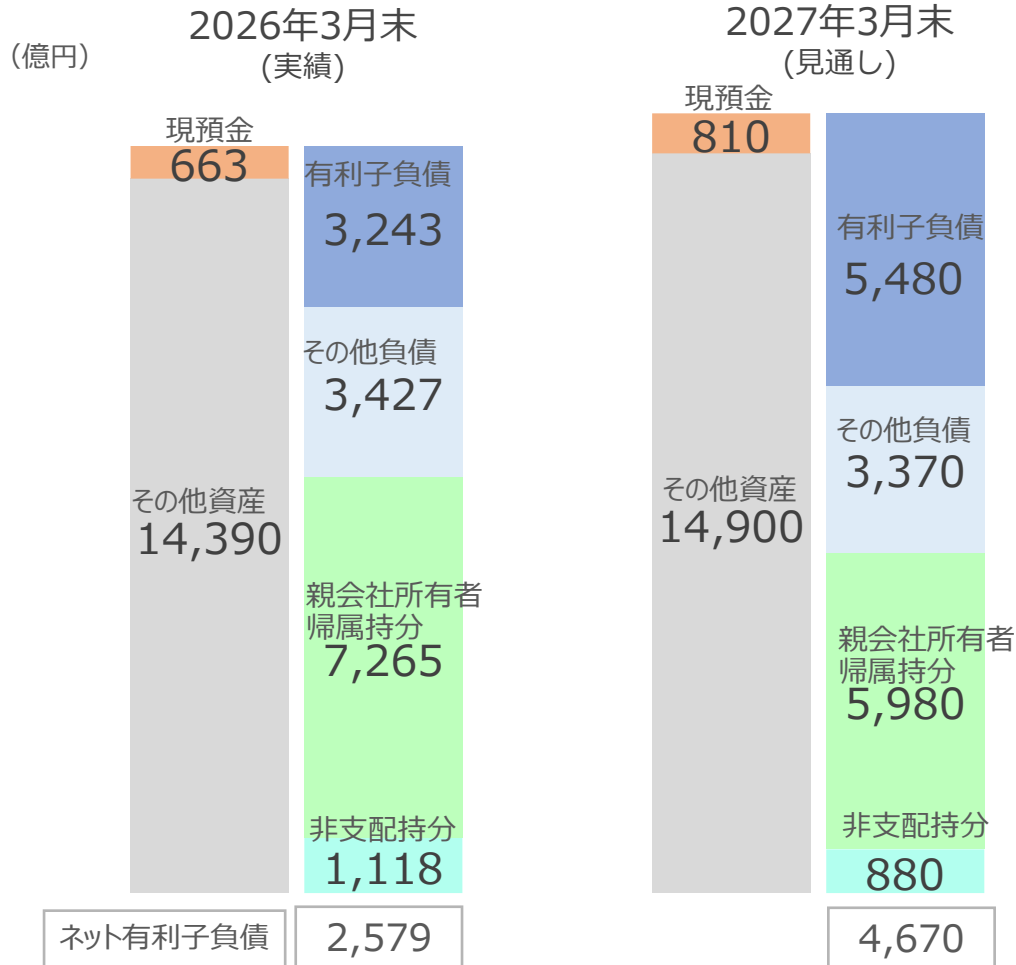
事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2026年度	前年同期比	
		実績	見通し	差異	増減率
資源	売上高	57	100	+ 43	-
	営業損益	1,009	970	▲ 39	▲4%
金属・リサイクル(金属R)	売上高	4,021	4,100	+ 79	+2%
	営業損益	376	270	▲ 106	▲28%
調整等	売上高	-	-	-	-
	営業損益	10	-	▲ 10	▲100%
セグメント合計	売上高	4,079	4,200	+ 121	+3%
	営業損益	1,395	1,240	▲ 155	▲11%

* 子現地決算において回収可能額の見直しにより繰延税金資産追加計上(持分法取込)

2026年度見通し 連結バランスシート・キャッシュフロー/株主還元

■ 連結バランスシート



CBの発行により、有利子負債が増加する見込み。また、自己株式の取得により自己資本が減少し、資本効率が改善する見込み

■ 連結キャッシュフロー

	2026年度 見通し
営業キャッシュフロー	1,250
投資キャッシュフロー	▲ 730
フリーキャッシュフロー	520
財務キャッシュフロー	▲ 360
現金同等物の増減額	160
為替変動による影響等	▲ 10

■ 株主還元

配当方針

連結配当性向25%程度を基本とした上で、配当の下限を20円/株とする。但し、大規模な資産売却や自己株式の取得を行う場合は総還元性向も考慮して別途検討する。また、2027年3月期の株主還元方針については多額の自己株式の取得を行うため、配当は下限の20円/株とする。

(参考：2027年3月期の総還元性向は約235%)

※自己株式取得額 2,500億円想定

	2027年3月期	
1株あたり 配当金	予定	
	20円	
	中間 10円	期末 10円
配当性向	16%	

Appendix

トピックス（2025年度）

フォーカス事業

- 4月 インド現地法人を設立
- 5月 ひたちなか新工場（仮称）に隣接する工業用地の新規取得を決定
- 6月 次世代半導体の高性能化に不可欠な高純度CVD・ALD材料の供給体制を強化 —急速な成長を遂げる生成AIのさらなる進化に貢献—
- 7月 経済産業省による半導体用スパッタリングターゲットに係る供給確保計画の認定について
- 7月 結晶材料の増産に向けた設備投資の決定
- 9月 次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画
- 9月 パナソニックグループとの使用済み家電からの銅資源循環スキームの共創を開始
- 9月 「データインフラ材料事業推進部」新設
- 10月 結晶材料の増産に向けた設備投資の追加の決定
- 10月 レーザー核融合スタートアップの株式会社EX-Fusionへの出資決定
- 11月 Alloyed社グループによる新型3Dプリント・マイクロタービンの開発・試験成功
- 12月 株式会社レゾナック・ハードディスクから「開発部門表彰」を受賞
- 1月 りん青銅条の生産終了の決定
- 2月 結晶材料の増産に向けた設備投資の追加の決定
- 2月 東邦チタニウム株式会社の完全子会社化の決定
- 2月 Rapidus株式会社への出資
- 3月 株式会社Gaianixxの株式の追加取得
- 3月 茨城事業所(日立地区)における高純度CVD・ALD材料の量産ライン立ち上げ完了
- 3月 ひたちなか新工場における半導体用スパッタリングターゲットの増産に向けた設備投資の決定

トピックス（2025年度）

ベース事業

- 6月 豪州ミネラルサンド鉱床開発プロジェクト参画に向けた契約締結 — レアメタル資源の長期安定確保に向けて —
- 6月 金属・リサイクル事業の収益力強化に向けた方向性について
- 9月 リサイクル原料の増処理に向けた設備投資の決定
- 11月 Copi PJ(豪州ミネラルサンド鉱床開発プロジェクト)の開発評価への参加を丸紅が決定
- 11月 パンパシフィック・カッパーと三菱マテリアルの銅精鉱の購入・電気銅等の販売に係る事業の統合に関する基本合意書を締結
- 12月 ケチュア銅プロジェクト権益譲渡
- 3月 カセロネス銅鉱山権益一部譲渡及びフロンテラ地域における銅鉱山プロジェクト権益の譲渡の決定
- 3月 Fireweed社の株式取得の決定

会社概要

半導体・情報通信分野に欠かせない先端素材をマーケットに供給するグローバルトップメーカー

事業・主力製品

高度な技術的差別化の実現により、グローバル競争優位性を持つ当社成長戦略のコア事業

★AIサーバ関連

フォーカス事業

半導体材料

薄膜材料

半導体用ターゲット★



約65%¹

半導体ウエハにナノレベルの膜を形成するために必要な金属材料

カドミウム・ジंक・テルル

CdZnTe基板



放射線・赤外線センサ素子に使用される単結晶基板

磁性材用ターゲット★



大容量ハードディスクドライブに膜を形成するために必要な金属材料

CVD⁴/ALD⁵プリカーサ材料



CVD/ALDによる薄膜形成に使用される金属原料

インジウムリン

InP基板★



光通信の受発光素子材料

タンタル・ニオブ

タンタル粉★

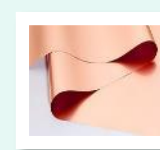


半導体用ターゲットやキャパシタに使用される金属粉末

情報通信材料

機能材料

圧延銅箔

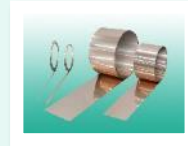


78%²

FPC（フレキシブルプリント基板）³に用いられる屈曲性に優れた金属箔

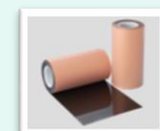
タツタ電線

チタン銅★



強度・導電性・曲げ加工性に優れた合金材料

電磁波シールドフィルム



モバイル機器の回路を電磁波ノイズから保護する機能性フィルム

最終用途例

AIサーバ



ウェアラブル



スマートフォン



モビリティ (xEV/ADAS)



銅、レアメタル（タンタル、チタンなど）のサプライチェーン強化を通じて、フォーカス事業の成長を支える

注1：当社推定；注2：富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」（2023年実績、FPC向けのみ、出荷数量ベース）；注3：FPC(Flexible Printed Circuits)：絶縁性を持ったベースフィルムと銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板；注4：Chemical Vapor Deposition；注5：Atomic Layer Deposition

長期ビジョン・沿革

●長期ビジョン策定

●基本方針

「装置産業型企业」から「技術立脚型企业」への転身により、激化する国際競争の中にあっても高収益体質を実現、半導体材料/情報通信材料のグローバルリーダーとして、持続可能な社会の実現に貢献する

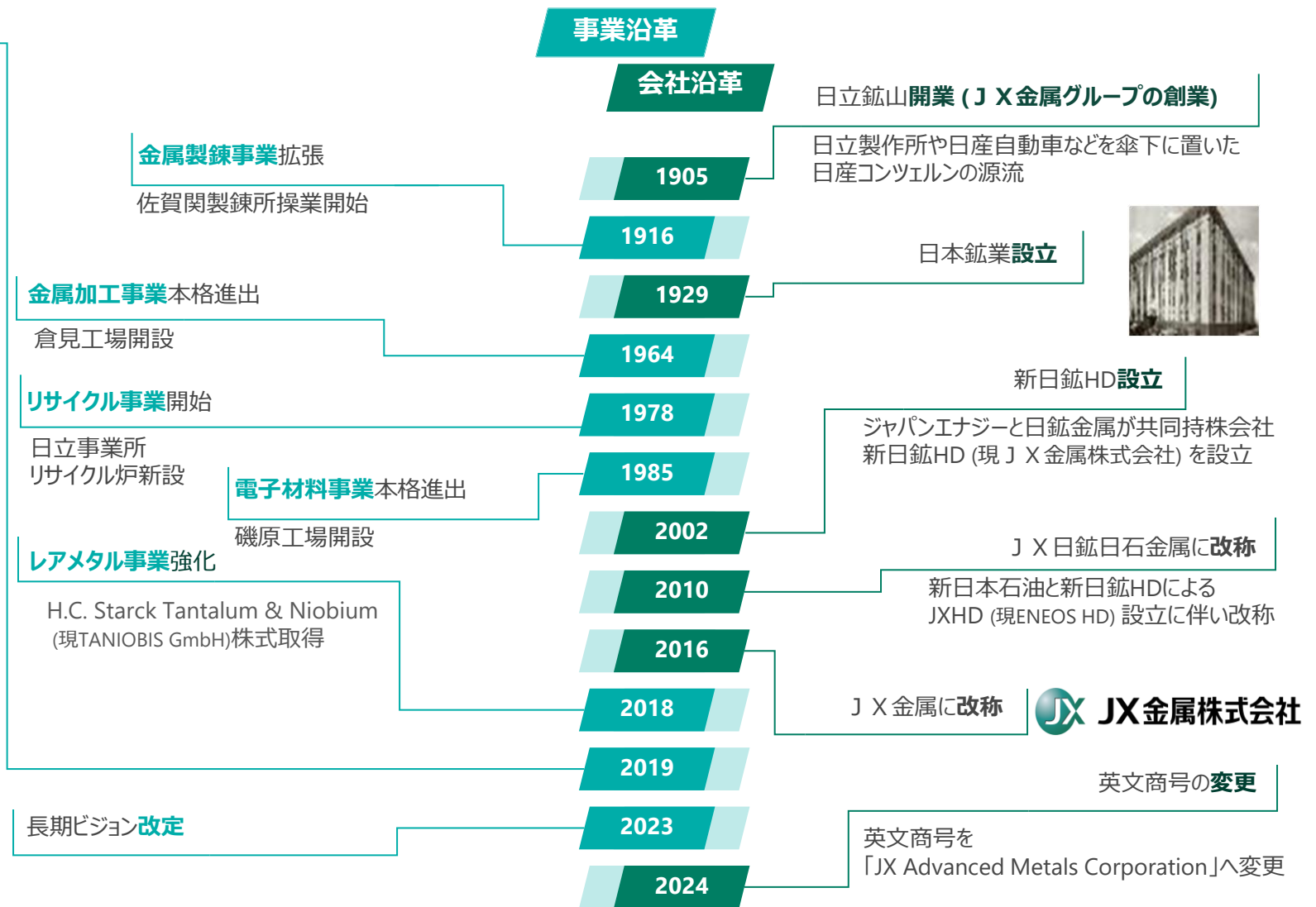
●目指すポートフォリオ

【成長】フォーカス事業

- 成長戦略のコアとして位置づけ
- 技術による差別化によりグローバル競争で優位に立ち、市場成長以上の利益成長を図る

【基盤】ベース事業

- サプライチェーン強化を通じてフォーカス事業の成長を支える
- 半導体材料/情報通信材料に不可欠な銅及びレアメタルを中心ドメインと位置付ける

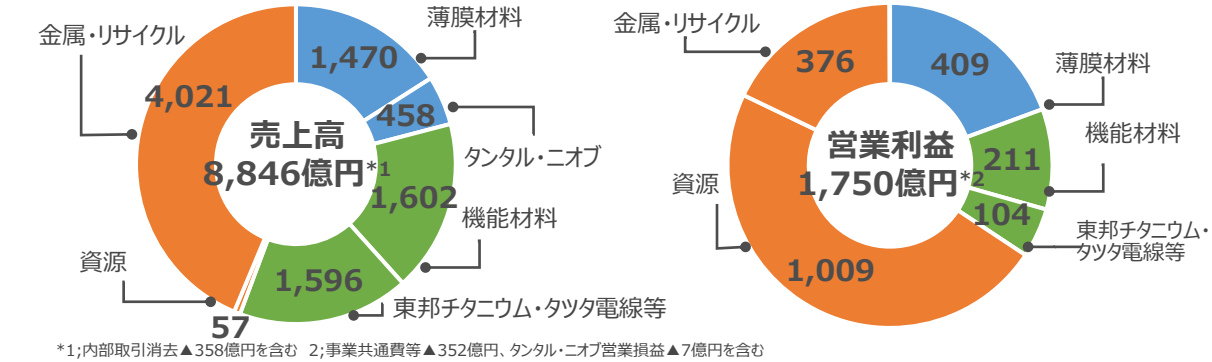


主な製品一覧

主な製品（写真）



サブセグメント別 売上高/営業損益（2025年度）



*1;内部取引消去▲358億円を含む 2;事業共通費等▲352億円、タンタル・ニオブ営業損益▲7億円を含む

(2026年5月時点)

セグメント	サブセグメント	主な製品	主要用途	最終用途例	
フォーカス事業	半導体材料	薄膜 ^(はくまく) 材料	半導体用ターゲット	半導体ウエハ上の金属薄膜形成	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）
		磁性材用ターゲット	磁気記録メディア上の金属薄膜形成	HDD（データセンター）、磁気センサ	
		インジウムリン（InP）基板	光⇄電気の変換（受発光素子）	光通信（データセンター）	
		カドミウム・ジンク・テルル（CdZnTe）基板	赤外線検知、放射線検知	防衛システム、CTスキャン	
		CVD・ALD用材料	半導体用配線材料	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）	
	情報通信材料	タンタル・ニオブ	スパッタリングターゲット向けタンタル粉	半導体用ターゲット向け材料	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）
			キャパシタ向けタンタル粉	タンタルキャパシタ向け材料	タンタルキャパシタ（データセンター、PC）
		機能材料	圧延銅箔	FPC（フレキシブルプリント基板）用材料	スマートフォン、ウェアラブル、ロボット、医療用カテーテル
			チタン銅	コネクタ用材料、カメラばね用材料	サーバ向けコネクタ（データセンター）、カメラモジュール
			東邦チタニウム・タツタ電線	(東邦チタ) スポンジチタン	航空機エンジン部品、機体材料
ベース事業	基礎材料	資源	化学品（超微粉ニッケル）	積層セラミックコンデンサ 内部電極向け材料	積層セラミックコンデンサ
			THC触媒	ポリプロピレン、ポリオレフィン製造用触媒	自動車内外装、家電製品、包装材
		金属・リサイクル	(タツタ) インフラ・産業機器用電線	電線向け材料	発電所・プラント向け電線・ケーブル
			電磁波シールドフィルム	電子モバイル機器の内部回路保護	スマートフォン

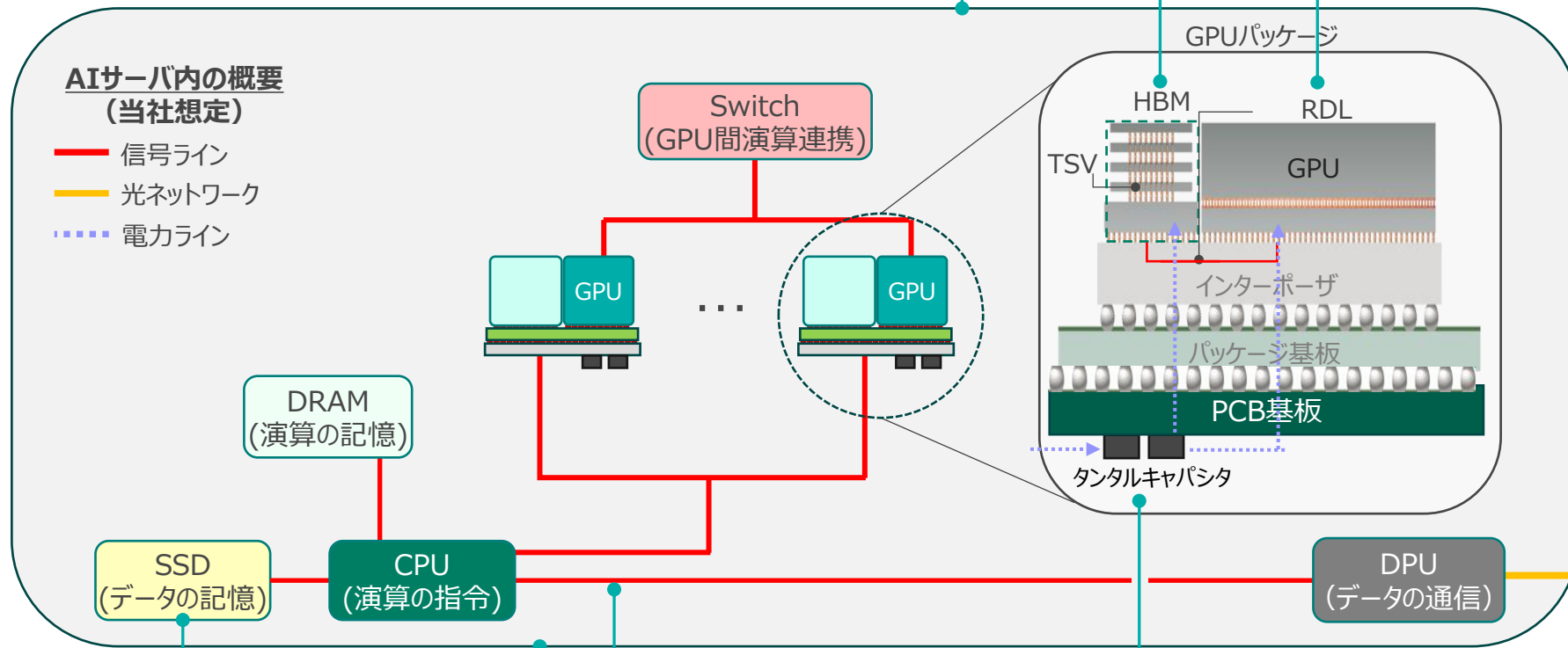
銅精鉱・電気銅・モリブデン精鉱
 (持分比率) カセロネス銅鉱山：25% ロス・ペランプレス銅鉱山：12.52% エスコンディーダ銅鉱山：3%
 電気銅、型銅、貴金属、硫酸
 (持分比率) パンパシフィック・銅：47.8%

当社データセンター関連製品

半導体材料

機能材料

グローバルシェア



半導体用ターゲット



約65%*1

漏水センサ(タッタ電線)



CVD/ALD
プリカーサ材料



チタン銅

約60%*1



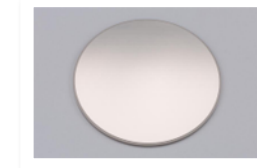
タンタル粉

約50%*2



InP基板

約40%*1



磁性材用ターゲット

約60%*1

*1: 当社推定 *2: 当社推定。スパッタリングターゲット向け含む

半導体用ターゲットについて

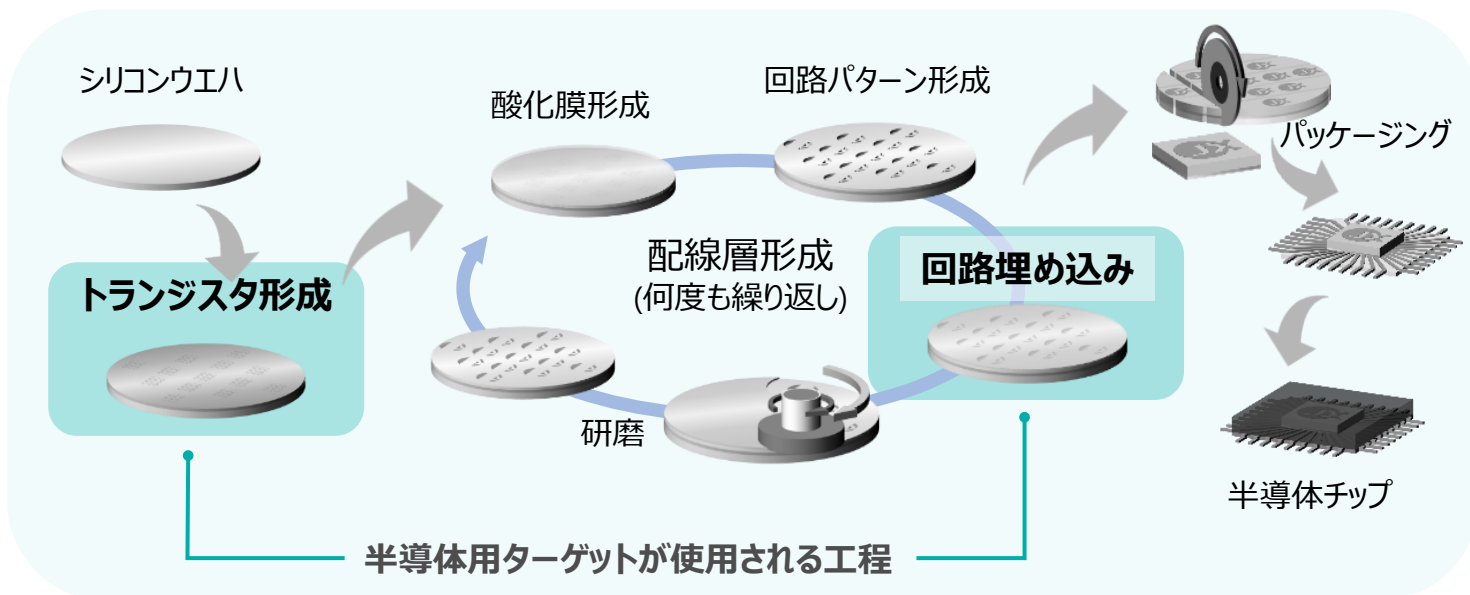
半導体用ターゲットとは



世界シェア
約6割
No.1

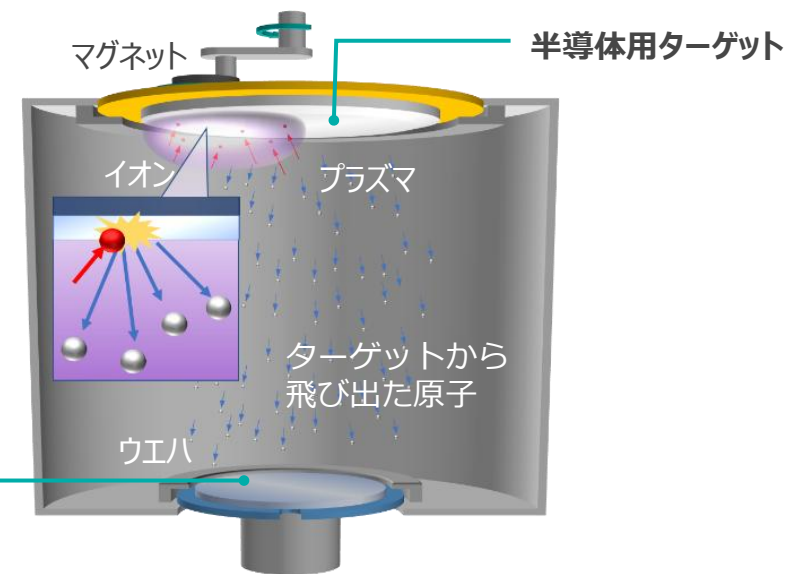
シリコンウエハ上にトランジスタや配線層を形成するためのPVD*1工程で必要となる高純度の金属材料

半導体チップ製造における使用工程

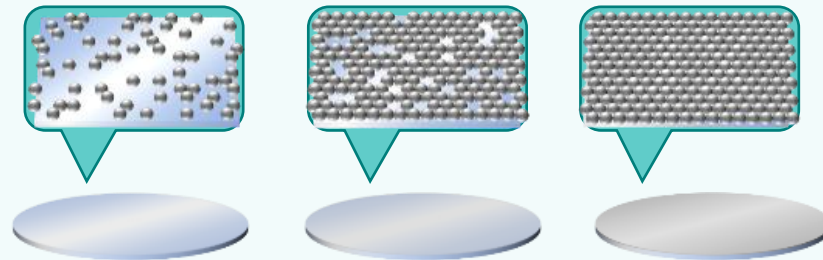


使用過程・構造

(スパッタチャンバー内部模式図)



スパッタリングプロセスで膜が形成される様子(模式図)



*1 Physical Vapor Deposition (物理気相成長法) の略。金属材料を気化させて基板に成膜する方法。スパッタリング法は代表的なPVDプロセスのひとつ

グローバルトップシェアを実現する当社半導体用ターゲットの強み

技術力の高さやメーカー・顧客との関係性、グローバルな生産体制を完備し、グローバルトップシェアを実現

世界トップクラスの 技術力

高純度化、組成・組織制御、
表面処理、分析評価などで高い
技術力を保有



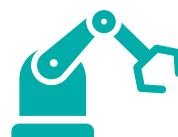
世界最高レベルの
高純度銅
純度
99.9999999%

半導体製造装置メーカー との強固な関係

装置メーカーとの関係構築を通じて
装置の標準材料への指定を獲得



J X 金属



装置メーカー

顧客(半導体メーカー) との信頼関係

長年にわたる取引実績を有し
優秀なサプライヤーとして表彰獲得



TSMC



Intel



SK hynix

グローバルな生産体制

半導体メーカーの生産拠点との
地理的優位性のある拠点を保有



ひたちなか工場

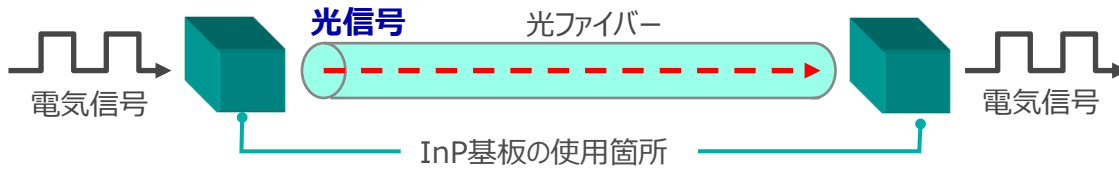
米アリゾナ・メサ工場

InP基板について

- 光通信用途で使用するインジウムリン（InP）基板は、**データセンター向けで販売好調**
- 急速な市場の拡大を捕捉すべく、**更なる増産に向けた設備投資を決定**
- 今後**データセンター内通信の光化の進展に伴い、更なる成長ポテンシャル**も期待

InP基板とは

- 電気信号と光信号の変換を行う光通信用途として、データセンター・インターネット網に使用される材料
- InPは光トランシーバーの受光素子・発光素子に使用される



InP収益規模拡大に向けた取り組み

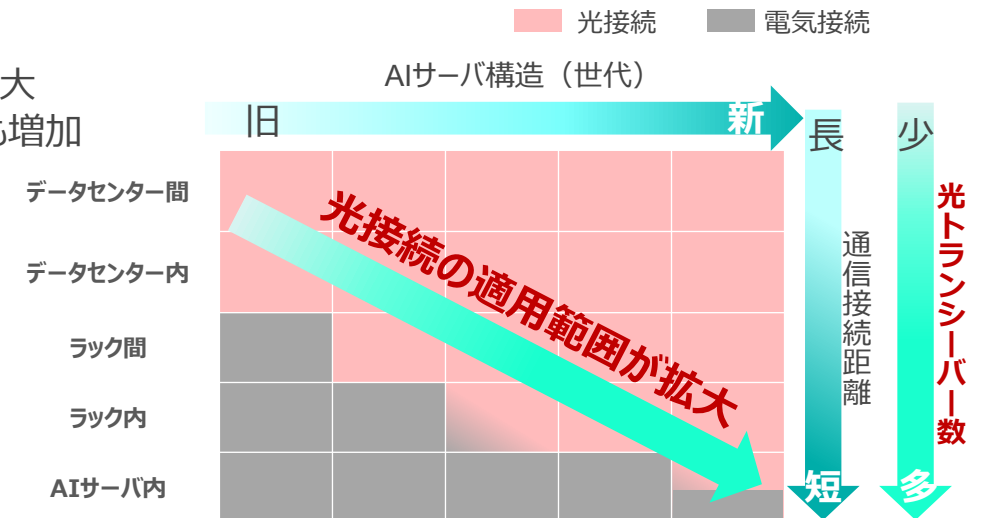
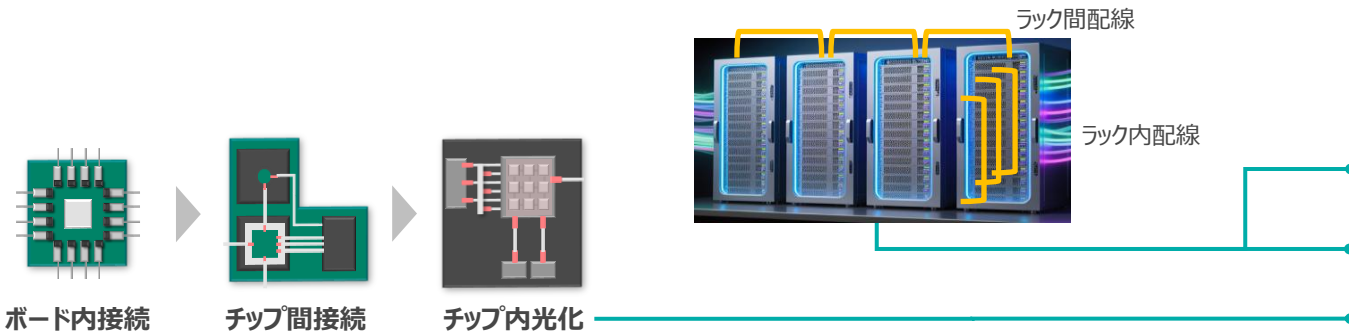
- 26年2月には更なる増強投資を公表。2030年に約3倍（2025年比）の能力増強を行い、基板大型化のニーズにも対応
- 需給タイトな市場環境を好機ととらえ、価格改定を推進中

リリース	生産能力 - 2025年度比	投資額
2025年7月	2割増	約15億円
2025年10月	約5割増*1	約33億円
今回 2026年2月	約3倍*2 (27年度以降順次稼働予定)	約200億円

*1;25年7月リリースと合わせた生産能力 *2;25年7月、10月リリースと合わせた生産能力

電気から光へのシフトに伴う成長機会

- 高速通信化・データセンター内の消費電力増加に伴い、近距離向けにも光通信の適用が拡大
- 光通信の適用範囲拡大に伴いトランシーバー使用量が増えることで、当社InP基板の需要も増加

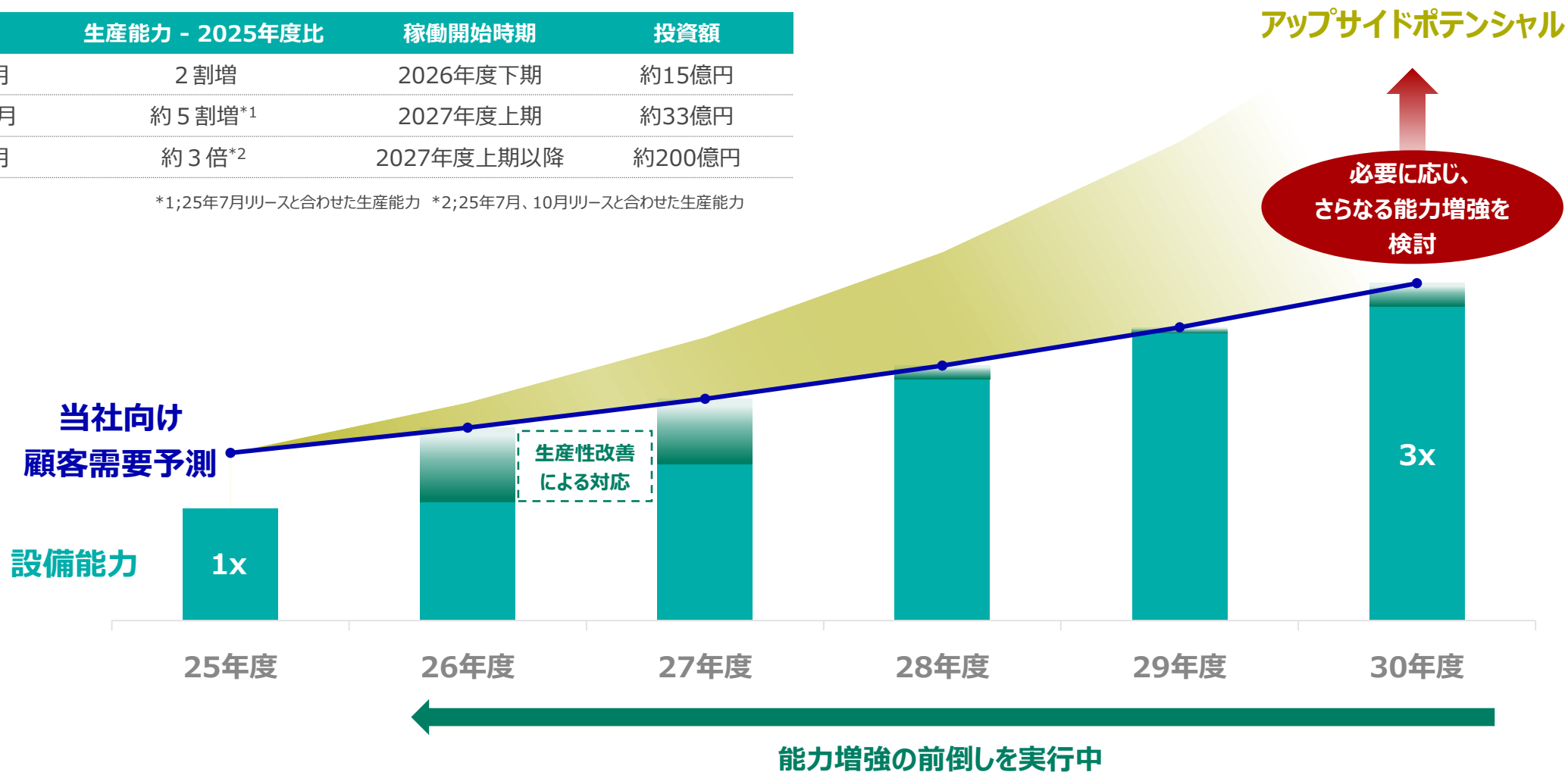


InP基板 能力増強計画と需要予測イメージ（データコム向け）

決定済みの能力増強計画

リリース	生産能力 - 2025年度比	稼働開始時期	投資額
2025年7月	2割増	2026年度下期	約15億円
2025年10月	約5割増 ^{*1}	2027年度上期	約33億円
2026年2月	約3倍 ^{*2}	2027年度上期以降	約200億円

^{*1};25年7月リリースと合わせた生産能力 ^{*2};25年7月、10月リリースと合わせた生産能力



ベース事業の取り組み

長期ビジョンに沿ったフォーカス事業中心のポートフォリオに向けて、ベース事業の最適な体制を構築

ベース事業における主な取り組み：事業規模の適正化、フォーカス事業のサプライチェーン確保を着実に実行

2022年度

2023年度

2024年度

2025年度

資源事業

ベースメタルから
レアメタルへ

Mibra鉱山(タンタル)投資

カセロネス銅鉱山およびロス・ペランブレス銅鉱山権益の一部売却

カセロネス銅鉱山権益の追加売却

Copi PJ(レアメタル・レアアース)参入・丸紅の開発調査への参加

カセロネス銅鉱山の一部権益・フロンテラ地域における銅鉱山開発プロジェクト権益譲渡

Fireweed社(レアメタル等)株式取得
(2026年4月クロージング)

金属・リサイクル事業

リサイクル中心の
より効率的な体制へ

韓国の銅製錬JVのLS-Nikko全持分売却

eCycleの株式取得(双日との協業)

パンパシフィック・カッパー株式の一部譲渡

製錬・リサイクル事業の高付加価値化(三菱商事との協業)

パンパシフィック・カッパー(JX金属・三井金属・丸紅)と三菱マテリアルの銅精鉱の購入・電気銅等の販売に係る事業の統合

- 統合に向けて基本合意書を締結
- デューデリジェンス等実施中

本資料に記載されている当社の目標、計画、見積もり、予測、予想、ターゲットその他の将来情報については、本資料の作成時点において、当社が入手できる情報をもとに、一定の前提に基づく当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の経済情勢・市場環境、事業活動、他社との競争環境その他様々な要因等により、本資料の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なることがあります。

